# 1 适用范围

本文档是由北京联盛德微电子提供给PCB加工方的工艺文件，该文件规定了PCB加工中的要求、注意事项、数量、阻抗控制等信息， PCB加工方务必严格遵守，如果遇到加工困难或者要求对方难以达到，需要设计人员与加工方协商解决。

本文档阅读对象为：产品设计、测试、生产等人员，其中部分内容可以提供给PCB加工方阅读。

# 2 PCB加工基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件类型 | ☑GERBER □ PCB文件 | |
| PCB层数 | □2 ☑4 □ 6 □ 8 □ | |
| 成品板厚 | 0.8 mm，±10% | |
| 成品尺寸 | 16mm\*24mm | |
| 表面工艺处理 | □热风整平 ☑沉金 □OSP/防氧化处理 □ 镀金手指 | |
| 过孔盖油处理 | ☑过孔盖油 □ QFN内塞孔 □BGA内塞孔 □ 按文件设计 | |
| 表面丝印颜色 | 单面印刷 □黑色 ☑ 白色 | |
| 表面阻焊颜色 | 双面印刷 ☑绿色 □蓝色 □白色 □ 黑色 | |
| 基铜厚内外层 | ☑35uM/10Z □ 18uM/5Z □ 70uM/20Z | |
| 板基材料 | ☑FR-4 □ Hightg170 □ Rogers □ RCC | |
| 介电常数 | ☑4.3 □4.5 | |
| 设计参数 | 最小线宽/线距 mil | ☑5/5 □6/6 □ 4/6 |
| 最小孔内/外经 mil | 10/20mil |
| 交货附件 | ☑电测报告 ☑检验报告 □菲林 ☑阻抗报告 □其它 | |
| 环保要求 | ☑RoHS | |

注意事项：☑表示选择，□表示未选择， 自行填写

# 3 叠层方式

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叠层次序 | Gerber文件后缀名 | PCB层描述 | 正片/负片 | 其它说明 |  |
| 1 | Top | 顶层 | ☑正 □负 |  |  |
| 2 | GND1 | 第二层 | ☑正 □负 |  |  |
| 3 | GND2 | 第三层 | ☑正 □负 |  |  |
| 4 | Bottom | 底层 | ☑正 □负 |  |  |

# 4阻抗控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻抗描述 | 设计参数信息，阻抗控制位置 | | | |
| 顶层单微带线阻抗50欧 | 线宽mil | 10.5 | 微带线所在层 | 顶层 |
| 线与同层地平面间距 mil | 6 | 阻抗控制参考层 | GND(第二层) |

**注意事项：如果阻抗控制线跨层，并增加表格，分别描述。**

阻抗要求

1. 下图中绿色高亮部分的线宽为10.5MIL，地间距为6MIL，单端阻抗控制50欧。

